

本社:〒160-8366

東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビルディング

報告書番号 : PCN#20121003002

2012年10月15日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 営業・技術本部 カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 大

HPA TO-xxx パッケージ 一部製品 出荷梱包部材変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施について通知のみを目的としたものになります。変更の詳細は、次頁 以降をご参照下さい。

本通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前24ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。 また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは <u>pcn_tij@list.ti.com</u> にお問い合わせ下さい。

以上

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

変更概要						
通知タイプ	☐Initial notice (Plan)	■Final notice				
変更概要	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical		
	Wafer Fab	□Site	□Process	□Material		
	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material		
	Assembly	□Site	□Process	□Material		
	Test	□Site	□Process			
	■Others	■Packing/Shipping/Labeling □ -				
変更内容	HPA TO-xxx パッケージ 一部製品 出荷梱包部材変更					
	現行 : Conductive 袋使用梱包					
	変更後:Conductive 箱使用梱包					
対象製品	対象製品リスト参照					
変更時期	10月下旬の出荷より予定しています。					
品質認定試験	□計画	□終了				
製品表示	■変更無し	□変更あり				
備考	_					

変更内容

内容:今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TO-xxxパッケージ 一部製品の出荷梱包部材について、現行 Conductive袋を使用していますが、輸送中におけるプラスチックチューブ損傷排除の為に、 Conductive箱に変更します。下記を参照ください。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差),外観,動作特性,品質,信頼性への影響はありません。

変更内容現行変更後出荷梱包部材Conductive袋Conductive箱

理由:輸送中におけるプラスチックチューブ損傷排除の為

対象製品リスト

対象製品名						
4213AM	INA117BM	OPA128SM	OPA445BM	OPA637AM		
4213SM	INA117SM	OPA2111AM	OPA541AM	OPA637BM		
INA101AM	INA117SMQ	OPA2111BM	OPA541BM	0PA637SM		
INA101CM	OPA111AM	OPA2111KM	OPA541SM	0PT301M		
INA101SM	OPA111BM	OPA2541AM	OPA627AM			
INA105AM	OPA128JM	OPA2541BM	OPA627BM			
INA105BM	OPA128KM	OPA2541SM	OPA627EM			
INA117AM	OPA128LM	OPA2541SMQ	OPA627SM			

詳細:

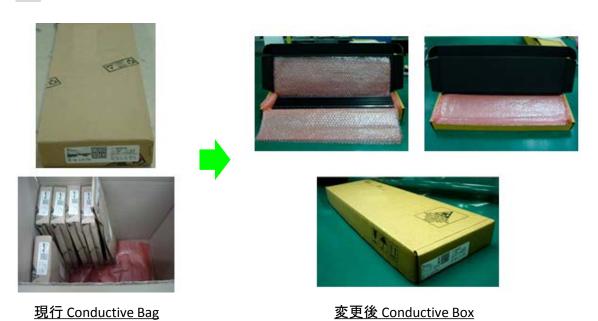


図1 出荷梱包部材比較